



Таблиця 1 - позначення отворів

Symbol	Count	Hole Size	Plated
★	200	0.25mm	Plated
☆	255	0.30mm	Plated
⊙	4	0.32mm	Plated
⊘	2	0.75mm	Plated
⊚	2	0.80mm	Plated
○	26	0.90mm	Plated
⊖	8	0.99mm	Plated
⊗	10	1.00mm	Plated
⊛	20	1.02mm	Plated
⊝	2	1.30mm	Plated
⊞	2	1.60mm	Plated
⊠	2	2.10mm	Plated
⊡	8	3.00mm	Plated
⊢	2	4.40mm	Plated
	543	Total	

Таблиця 2 - послідовність шарів друкованої плати

Material	Layer	Thickness	Dielectric Material	Type	Gerber
Surface Material	Top Overlay	0.01mm	Solder Resist	Legend	G10
Copper	Top Solder	0.04mm		Solder Mask	G11
Copper	Top Layer	0.04mm		Signal	GTL
Prepreg		0.10mm	PP-011	Dielectric	
Copper	GND Layer	0.02mm		Signal	G1
		1.06mm	Core	Dielectric	
Copper	VCC Layer	0.02mm		Signal	G2
Prepreg		0.10mm	PP-011	Dielectric	
Copper	Bottom Layer	0.04mm		Signal	GBL
Surface Material	Bottom Solder	0.01mm	Solder Resist	Solder Mask	GBS
	Bottom Overlay			Legend	G80
Total thickness: 1.39mm					

- \* Розміри для перевірок.
- 1. Крок координатної сітки 0,1 мм. Лінійкоординатні сітки нанесені через кожні 10 кроків.
- 2. Плата повинна відповідати ГОСТ 23752-79 III група жорсткості/Клас точності 4 по ГОСТ 23751-86.
- 3. Конфігурацію провідників витримати за координатною сіткою.
- 4. Основу плати виготовити з FR-4.
- 5. Слої плати та діелектрики виконати відповідно до таблиці 2 - послідовність шарів друкованої плати.
- 6. Клас точності 4 по ГОСТ 23751-86.
- 7. Плата повинна відповідати ГОСТ 23752-79. III група жорсткості.

DK92.4.7666.1002				
Зм. Арк.	№ докум.	Підп.	Дата	Плата друкована
Розроб.	Загребда А.		12.08.23	
Перев.	Ледевед Д.		12.08.23	
Т. контр.				
Н. контр.	Лисенко О.		13.08.23	КПІ ім. Ігоря Сікорського ФЕЛ, КЕОА, ДК-92
Утв.	Ледевед Д.		12.08.23	
Копія				
Лист			36 з.	21
Арк.			1	Аркцифр 1
Формат А1				